



**PALTEK、大量梱包ライン向けに
資材量を最適化する自動紙緩衝材梱包システムを提供開始
～紙資材梱包の自動化により効率化促進 第6回通販ソリューション展【春】に出展～**

株式会社PALTEK(本社:横浜市港北区、代表取締役社長:矢吹尚秀、証券コード:7587、以下PALTEK)は、紙梱包資材・システムのマーケットリーダーであるRanpak BV(本社:オランダ ヘールレン、Managing Director:Eric J. M. Laurensse、以下Ranpak社)の自動紙緩衝材梱包システム「AccuFill」の提供を開始します。PALTEKは、お客様の生産ラインや環境にあった自動紙緩衝材梱包システムを設計・提案することにより、大量な梱包ラインを有する事業者に対し資材コスト、資材保管スペース、梱包作業時間の削減を提案し、物流コスト低減に貢献します。

なお、PALTEKは、2018年5月9日(水)～11日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「第6回通販ソリューション展【春】」で、大量梱包ライン向け自動紙緩衝材梱包システム「AccuFill」を紹介します。

Ranpak社の自動紙緩衝材梱包システム「AccuFill」



AccuFill は、大量梱包ラインで使用する隙間埋め用紙資材の量を最適化する自動梱包システムです。最大 26 種類のサイズの箱に対応し、1 時間あたり 600 箱に紙資材を投入する処理能力を提供します。ライン上の箱を AccuFill のセンサーがスキャンし、箱のサイズや箱内側の製品体積を測定し、隙間を埋めるために必要な紙資材の量を計算します。その後、FillPak コンバータに情報を送り、必要な量の紙を排出・投入します。作業者は排出された最適量の紙資材で隙間埋めを行うため、資材コスト、梱包作業時間が大幅に削減されます。また、AccuFill は個々の箱データを収集し、すべての梱包作業を分析した詳細な分析レポートを出力できるため、フォローアップ分析を行うことで、梱包作業の効率と生産性を最適化します。

紙緩衝材は紙の持つ柔軟な対応力を生かし、緩衝、すき間埋め、ラッピングなど、さまざまな包装ニーズに対応できます。また、梱包用プラスチックの再利用率はわずか24%であるのに対して、梱包用紙資材の再利用率は73%にも上り、紙梱包資材の活用による環境負荷の低減が期待されます。Ranpak社のシステムを利用することによって梱包作業の高速化を図り、労働コストや梱包資材コスト、資材の保管スペースの削減などを含め、トータルコスト削減を提案することができます。

PALTEKは、長年、日本のエレクトロニクスメーカーに対して、FPGAやASSP、アナログ、メモリなどの半導体や受託設計サービスを提供し、エレクトロニクスメーカーの製品開発をサポートしてまいりました。これらの

技術力や経験を活かし、お客様の生産ラインや環境にあった自動緩衝材システムを設計・提案することにより、包装・梱包ラインの人的費、作業時間、材料費などトータルコストの低減に貢献してまいります。

PALTEKは、2018年5月9日(水)～11日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「第6回通販ソリューション展【春】」で、Ranpak社の大量梱包ライン向け自動紙緩衝材梱包システム「AccuFill」を紹介することで、大量な梱包ラインを有する事業者向けのコスト低減について提案してまいります。

● 展示会の概要

展示会名 : 第6回通販ソリューション展 春
開催日時 : 2018年5月9日(水)～11日(金) 10:00～18:00(11日のみ終了時間は17:00)
会場 : 東京ビッグサイト Ranpak/PALTEKブースは、東20-28
主催 : リード エグジビション ジャパン株式会社
URL : <http://www.ts-expo.jp/>

2018 Japan IT Week 春 ビッグサイト 内

第6回 通販ソリューション展 春

DIREX 春
ダイレックス

Ranpak社製品に関する詳細は、ウェブサイト <http://www.paltek.co.jp/products/ranpak/> をご覧ください。

Ranpak社について:

Ranpak社は世界初の環境問題に責任を持ったお客様の製品を保護する梱包資材を提供することを目指し、1972年に設立され、世界に230社以上の代理店、400箇所以上の拠点を有する世界最大の紙による梱包資材・システムメーカーです。40年以上に渡る経験から紙による緩衝材とすき間埋めの特許を400以上有し、世界で6万社のユーザーに提供しております。

Ranpak BV は、欧州およびアジアに 100 以上の販売代理店を有しています。西ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリスなど)の成熟市場、東ヨーロッパ(ポーランド、スロバキア、トルコ)の発展途上市場、およびアジア太平洋(オーストラリア、日本、シンガポールなど)など、世界中に拠点があります。

Ranpak社に関する詳細は、ウェブサイト <https://www.ranpak.com> をご覧下さい。

株式会社PALTEKについて:

PALTEKは、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェア等の設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。

PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。

PALTEKに関する詳細は、ウェブサイト <http://www.paltek.co.jp> をご覧下さい。

■この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1: ニュースリリースに関するお問い合わせ

株式会社PALTEK

担当者 : 広報担当 柴崎 由記

メールアドレス : pr@paltek.co.jp

所在地 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F

電話 : 045-477-2072 FAX : 045-477-2012

2: 製品に関するお問い合わせ

株式会社PALTEK

担当者 : デザインサービス事業部

メールアドレス : info_pal@paltek.co.jp

所在地 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 11F

電話 : 045-477-2009 FAX : 045-477-2146